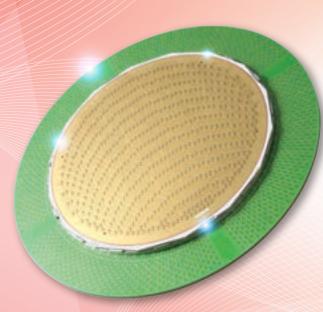
# 第63期 第2四半期のご報告

2021年4月1日~2021年9月30日



# **BUSINESS REPORT** JEM TODAY



JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION 日本電子材料株式会社 証券コード 6855

#### トップメッセージ

株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

2021年度第2四半期連結累計期間(2021年4月1日~2021年9月30日)の事業の 概況をご報告申し上げます。

#### ▋事業の経過及び成果

当社グループの主たる事業分野である半導体市場は、データセンター向けを中心に堅 調に推移いたしました。また、IoT、AIの活用の進展や5Gの普及に加え、自動車向けをはじ めとした半導体不足の解消に向けて、生産体制の強化も進められました。

このような事業環境の中、当第2四半期連結累計期間の売上高につきましては、メモ リーIC向け製品を中心に、国内向けに加え海外向けにつきまして、一時的な需要の伸びに より、前年同四半期を上回る結果となりました。利益面につきましても、売上高の増加及び 工場稼働率が一段と向上したこと等により、前年同四半期を上回る結果となりました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は11,226百万 円(前年同四半期比37.1%增)、営業利益は3.011百万円(前年同四半期比146.9% 増)、経常利益は3,044百万円(前年同四半期比164.5%増)となりました。親会社株主に 帰属する四半期純利益につきましては、2.145百万円(前年同四半期比150.4%増)となりました。



代表取締役社長 大久保 和正

#### ▮株主の皆様へ

今後の半導体市場につきましては、データセンター向け需要が引き続き堅調な成長が期待できる一方で、ノートパソコン 需要の一巡やスマートフォンの出荷台数の低下による影響が予想されます。また、半導体不足の影響につきましても、自動 車をはじめとして様々な製品の生産に拡大しており、世界的なサプライチェーンの混乱が続いております。プローブカード市 場につきましても、これらの市場動向の影響に加え、需要の端境期も重なり、不透明感が増しております。

中長期的には、半導体市場につきましては、5G、AI、IoTの普及等に牽引され、堅調な成長が見込まれており、プローブ カードも半導体市場に牽引され需要の拡大を予想しております。当社グループといたしましては、将来に向けて生産力の強 化及び製品力の向上により、企業価値の向上を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2021年12月

#### 業績の推移 ○売上高



#### ○営業利益



### ○親会社株主に帰属する



### 半導体の品質を支える。

スマートフォン、自動車、サーバー等多くの製品を支えている半導体。 当社グループは、半導体の品質を支える上で必要不可欠な プローブカードの開発、製造、販売を行っております。

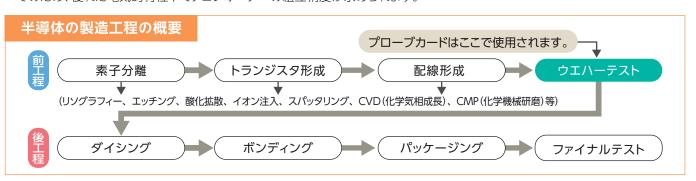


#### プローブカードの役割

プローブカードは、半導体の製造工程の中で、ウエハーテストとよばれる電気的な検査を行う工程で用いられます。

そして、半導体ウエハー上につくられたマイクロチップの電極に、最大10万本以上のプローブ(針)を接触させ、電気信号を半導体 テスターに伝える重要な役割を担っております。

そのため、優れた電気的特性やミクロンオーダーの組立精度が求められます。



#### ウエハーテストの概要

ウエハーテストでは、半導体ウエハー上につくられたマイ クロチップの電極に、プローブ(針)の先端部分を接触させ て電気的な検査を行い、マイクロチップの良否判別が行わ れます。



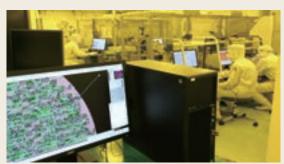
的に接続します。

ブ(針)が接触、半導体ウエハー

側に電気信号を伝えます。

#### **アドバンストプローブカード**(Mタイププローブカード)

半導体ウエハー上につくられたマイクロチップを同 時に多数測定することに優れた当社の主力製品です。 スマートフォンにも搭載されているDRAMやNAND 型フラッシュメモリー等の検査に使われています。また、 よりたくさんのプローブを搭載し高密度なプローブカー ドを生産するため、Mタイププローブカードには MEMSとよばれる高度な技術も用いられています。



MEMS製造(クリーンルーム)

Mタイプ プローブカード (MC)

#### 世界の主要な生産・販売拠点



これまで、当社は先駆的に海外にも生産・販売拠点を設けてまいりました。近年、半導体市場はアジアを中心に成長しており、 海外戦略の重要性が増しております。今後も当社グループは、海外拠点のネットワークを活かした販売活動の充実を図るとともに、 日本から各国拠点への一層の技術支援により、海外販売の強化を推進いたします。

### 技術の開発と製品化によって社会に貢献する。

半導体は、社会インフラを支えるIT基盤の中核技術として、また省エネルギーや環境に配慮した製品の基幹部品として、その重要性はますます高まっています。当社は、1970年に日本で最初にプローブカードの製造を開始し、長年エレクトロニクス産業の成長に貢献してまいりました。そしてこれからも、プローブカードを通じて半導体の品質を支えるとともに、技術の開発と製品化によって、社会に貢献する企業であり続けます。



#### Topic

#### 新市場区分における「スタンダード市場」の選択に関するお知らせ

当社は、2021年7月9日付で株式会社東京証券取引所より、「新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果について」を受領し、新市場区分(2022年4月4日移行予定)における「プライム市場」並びに「スタンダード市場」の上場維持基準に適合しているこ

とを確認いたしました。この結果を踏まえ、当社グループの持続的な企業価値向上の観点から新市場区分の移行先を検討した結果、「スタンダード市場」を選択する旨を2021年11月9日開催の取締役会において決議いたしました。

#### 株式事項(2021年9月30日現在)

発行可能株式総数40,000,000株発行済株式の総数12,075,480株株 主数11,086名

#### 大株主(2021年9月30日現在)

株主名	持株数	持株比率
(有) 大 久 保 興 産	1,016 千株	8.43 %
日本マスタートラスト信託銀行㈱	819	6.79
大 久 保 和 正	498	4.12
㈱日本カストディ銀行	369	3.06
㈱ 三 菱 U F J 銀 行	309	2.56
古 山 陽 一	230	1.90
大 久 保 英 正	228	1.89
R E F U N D 107 - C L I E N T A C (常任代理人:シティバンク、エヌ・エイ東京支店)	209	1.73
東海東京証券㈱	176	1.46
明治安田生命保険相互会社	169	1.40

(注)持株比率は、自己株式(15,680株)を除いて計算しております。

#### 役 員 (2021年9月30日現在)

取締役	
代表取締役社長 社長執行役員 (営業統括担当)	<sup>おおくぼ</sup> かずまさ 大久保 和正
専務取締役 専務執行役員 管理部門統括部長 (管理部門統括担当)	<sup>あだち</sup> やすたか 足立 安孝
取締役	いのうえ ひろし 井上 廣志*
取締役	<sup>なかもと</sup> だいすけ 中 本 大 介 *
取締役 常勤監査等委員	titus state <b>竹原 克尚</b>
取締役 監査等委員	ta ta ta was ta
取締役 監査等委員	ょしだ ひろゆき <b>吉 田 博 之 *</b>
	** / + 5± / J Fi √ × 5

\*は社外取締役

執 行 役 員		
副社長執行役員 品質統括部長 兼 生産管理統括部長 (品質統括、生産管理統括担当)	s 呉	<sub>てよぶ</sub> 泰 燁
常務執行役員 (MEMS統括担当)	<sup>さかた</sup> 坂 田	でるひさ <b>輝 久</b>
上席執行役員 本社MEMS工場長		ゅういちろう <b>圣 一 郎</b>
執行役員 MEMS統括部長	<sup>みやもと</sup> 宮 本	ょしゆき <b>佳 幸</b>
執行役員 生産統括部長 (生産統括担当)	<sup>ふじい</sup> 藤 井	<sub>あきひこ</sub> 昭 彦
執行役員 製品技術統括部長 (製品技術統括担当)	<sup>さわい</sup> 澤 井	もりやす <b>守 康</b>
執行役員 営業統括部長	りゅう <b>龍</b>	けいいち <b>圭</b> 一

## JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION 日本電子材料株式会社

〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目5番13号 https://www.jem-net.co.jp/

#### 会社概要(2021年9月30日現在)

英	訳	名	JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

日本雷子材料株式会社

住	所	兵庫県尼崎市西長洲町2丁目5番13号 TEL.06-6482-2007 (代表)
---	---	---

設 立 1960年4月6日

資 本 金 2,479,893千円

事業内容 ●半導体検査用部品の開発・製造・販売

●電子管部品の製造・販売

株式市場 東京証券取引所市場第一部

証券コード 6855

#### 株主メモ

事 業 年 度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月中
基 準 日	定時株主総会 … 3月31日 剰余金の配当 … 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日
単 元 株 式 数	100株
株 主 名 簿 管 理 人 特別□座の□座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社
同 連 絡 先	三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 電話 <b>西</b> ,0120-094-777 (通話料無料) ホームページ https://www.tr.mufg.jp/daikou/
公 告 の 方 法	当会社の公告方法は、電子公告とします。 ただし事故その他のやむを得ない事由に より電子公告をすることができないとき は、日本経済新聞に掲載します。 当社の公告掲載URLは次のとおりです。 https://www.jem-net.co.jp/

- (注) 1. 株主様の住所変更、買取請求、その他各種お手続きにつきましては、原則、 □座を開設されている□座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。□座を開設されている証券会社等へお問合せ下さい。
  - 2. 特別□座に記録された株式に関するお手続きにつきましては、上記特別□ 座の□座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問合せ下さい。なお、三菱UFJ 信託銀行全国各支店でもお取次ぎいたします。
  - 3. 未受領の配当金に関するご照会などは三菱UFJ信託銀行にお問合せ下さい。





